

# 無電解銀めっき液

Electroless Silver Plating Solution

# トップシルベACC / トップシルベAG

## TOP SILVE ACC / TOP SILVE AG

### ▶ 銅上の無電解銀めっき液『トップシルベACC』

Electroless silver plating on copper : TOP SILVE ACC

### ▶ 無電解ニッケル、無電解ニッケル／パラジウムめっき上の銀めっき液『トップシルベAG』

Electroless silver plating solution on electroless nickel, nickel/palladium plating : TOP SILVE AG

### ▶ 銀焼結接合に対応、下地金属の腐食を抑制する無電解銀めっき液

Applicable to silver sintered bonding / prevent the corrosion of undercoat

#### 銅張絶縁回路基板用プロセス For Cu clad dielectric substrate



#### アルミ張絶縁回路基板用プロセス For Al clad dielectric substrate



### トップシルベACC / トップシルベAG TOP SILVE ACC / TOP SILVE AG

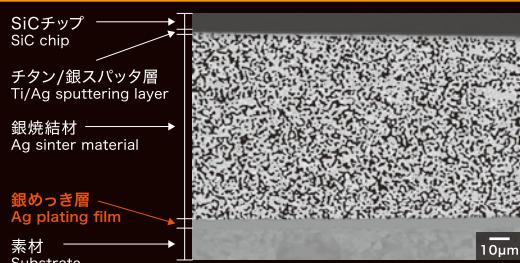
#### 下地金属の腐食を抑制した無電解銀めっき液 Electroless silver plating solution to prevent base metal corrosion



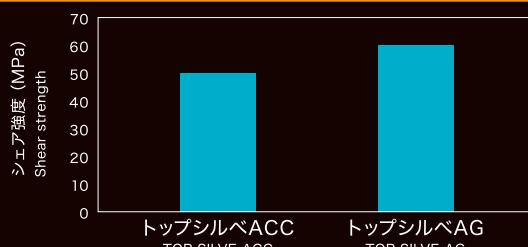
無電解銀めっき後の断面SIM像  
SIM image of cross section(after electroless silver plating)

無電解ニッケル / 銀めっき後の断面SIM像  
SIM image of cross section(after electroless nickel/silver plating)

#### 優れた銀焼結接合性 High bonding strength in Ag sintered joint



銀焼結接合後の断面SEM像  
Cross section SEM image after Ag sinter jointing



銀焼結接合後のシェア試験結果  
Result of shear strength test after Ag sinter jointing

はんだ接合に代わる技術として注目される銀焼結接合に対応

For silver sinter jointing as the replacement of solder jointing

\*銀焼結接合：大阪大学 産業科学研究所内 F3D実装協働研究所のご協力により実施

Silver sinter joint : Presented by SANKEN, Osaka University Flexible 3D JISSO Collaborative Research Institute